

日本セラミックス協会 第27回秋季シンポジウム 日機装株式会社ランチョンセミナー 無料/昼食付

粉粒体物性評価の最新技術～分散と凝集のメカニズムと評価方法～
粒子径分布、形状、ガス吸着による比表面積・細孔分布、スラリー安定性

開催概要

日時 : 2014年9月10日(水) 12:00~13:00
 会場 : 鹿児島大学 (郡元キャンパス) 共通教育棟2号館1階 214号講義室
 発表者 : 日機装株式会社 インダストリアル事業本部 粒子計測機器部 GL佐藤 浩二
 参加費 : 無料・昼食付
 定員 : 50名

※定員になり次第終了致します。

※当日席に余裕がある場合はご入場頂けます。直接会場でご確認下さい。

セミナー内容

セラミックスを原料とするモノ作りでは、基礎となる粉粒体の物性評価および品質管理が重要である。本セミナーでは、特にスラリーの分散と凝集のメカニズムを解説すると共に、現在広く活用されているレーザー回折・散乱法、動的光散乱法による粒子径分布・ゼータ電位測定、最新のユニークな機構で大粒子(数十 μm)、高粘度(数十cp)の流動電位測定による分散性評価、ガス吸着による比表面積・細孔分布測定、蒸気吸着による親・疎水性、親・疎油性などの表面特性評価、そして画像解析による形状観察まで最新の物性評価装置を紹介する。

会場

共通教育棟2号館1階 214号講義室



申込方法

下記事項を記載の上、メールにてお申し込み下さい。<送信先: ad.particle@nikkiso.co.jp>

1.会社/機関名 2.事業所/部課名 3.役職 4.ご氏名 5.住所 6.電話 7.e-mail

ランチョン参加申込およびお問合せ先

日機装株式会社 インダストリアル事業本部 粒子計測機器部 ランチョンセミナー事務局: 泉 佳余子
 TEL: (042)392-3378 FAX: (042)392-3355 e-mail: ad.particle@nikkiso.co.jp

※8月11~15日まで夏季休暇を頂戴致します。ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承下さいませようお願い申し上げます。

以上